PAT-NO: JP409257601A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 09257601 A

TITLE: LOAD CELL

PUBN-DATE: October 3, 1997

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

SAKAMOTO, KOICHIRO MIZUSHIMA, SHINICHI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME COUNTRY

TEC CORP N/A

APPL-NO: JP08064222

APPL-DATE: March 21, 1996

INT-CL (IPC): G01L001/22, G01G003/14

ABSTRACT:

PROBLEM TO BE SOLVED: To reduce influence of temperature drift by alternately disposing a stain gate for detecting compression strain and another

strain gage for detecting tension strain in the form of a ring in the same

plane as a beam body, forming a bridge circuit with them.

SOLUTION: An insulating resin layer is formed on the upper face of a beam

body 12 and a pair of strain gage patterns RC1, RC2 for detecting compression

strain and another pair of strain gage patters RT1, RT2 of detection tension

strain are formed thereon. The patterns RC1, RC2 and The other patterns RT1,

RT2 are alternately connected to each other by a wiring pattern Le in the form

of a ring to form a bridge circuit. Thereby the bridge circuit close to a load

9/16/05, EAST Version: 2.0.1.4

cell of a Roverval's mechanism can be constituted with the one-sided beam body

12 to obtain output voltage corresponding to a deformation quantity of the beam

body 12. By such constitution, the pattern Le of the beam body 12 can be

shortened to reduce influence of temperature drift or the like and to enhance

an SN ratio.

COPYRIGHT: (C) 1997, JPO

9/16/05, EAST Version: 2.0.1.4

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号

特開平9-257601

(43)公開日 平成9年(1997)10月3日

(51) Int.CL ⁶		識別記号	庁内整理番号	ΡI		技術	表示箇所
G01L	1/22			G01L	1/22	В	
G01G	3/14			G01G	3/14		

審査請求 未請求 請求項の数3 OL (全 7 頁)

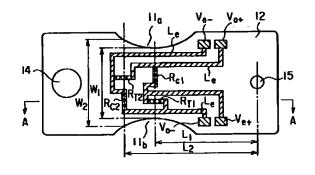
•		巻 全	未耐水 耐水坝の数3 UL (全 7 貝)
(21)出顧番号	特顧平 8-64222	(71)出願人	•
			株式会社テック
(22)出顧日	平成8年(1996)3月21日	ļ	静岡県田方郡大仁町大仁570番地
		(72)発明者	坂本 孝一郎
			静岡県三島市南町6番78号 株式会社テッ
			ク技術研究所内
		(72)発明者	水島 眞一
			静岡県三島市南灯6番78号 株式会社テッ
			ク技術研究所内
		(74)代理人	弁理士 鈴江 武彦

(54) 【発明の名称】 ロードセル

(57)【要約】

【課題】平板状のビーム体上のリード配線を短くして温度ドリフト等の影響を軽減して出力のS/N比を高める。

【解決手段】歪みゲージRCIを変形部11a,11bの最大歪み発生部位に位置させビーム体12の幅方向に平行に配置し、歪みゲージRT1も同様の位置にビーム体の長手方向に平行に配置し、また、歪みゲージRC2を変形部の最大歪み発生部位から所定距離固定端側に離れた位置にビーム体の幅方向に平行に配置し、歪みゲージRT2も同様の位置にビーム体の長手方向に平行に配置する。歪みゲージRCIのと歪みゲージRT1と入力端子Ve+を、歪みゲージRC2と歪みゲージRT1と出力端子Vo+を、歪みゲージRC2と歪みゲージRT1と出力端子Vo-を、歪みゲージRC2と歪みゲージRT2と入力場子Ve-を、それぞれリード配線Leで接続し、各歪みゲージをリング状に配置する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 片持ち梁構造からなり、中間部に変形部 を有するビーム体の一端を固定端、他端を自由端とし、 この自由端に荷重点を有する平板状のロードセルにおい て、圧縮歪みを検知する1対の第1の歪みゲージと引っ 張り歪みを検知する1対の第2の歪みゲージを、前記じ ーム体の同一平面上に、第1の歪みゲージと第2の歪み ゲージが交互になるようにしてリング状に配置し、この 各歪みゲージでブリッジ回路を構成したことを特徴とす るロードセル。

【請求項2】 片持ち梁構造からなり、中間部に変形部 を有するビーム体の一端を固定端、他端を自由端とし、 この自由端に荷重点を有する平板状のロードセルにおい て、圧縮歪みを検知する1対の第1の歪みゲージと引っ 張り歪みを検知する1対の第2の歪みゲージを、前記ビ ーム体の同一平面上に、荷重点から等しい距離で、かつ 変形部の最大歪み発生部位に配置するとともに、この第 1の歪みゲージと第2の歪みゲージが交互になるように してリング状に配置し、この各歪みゲージでブリッジ回 路を構成したことを特徴とするロードセル。

【請求項3】 片持ち梁構造からなり、中間部に変形部 を有するビーム体の一端を固定端、他端を自由端とし、 この自由端に荷重点を有する平板状のロードセルにおい て、圧縮歪みを検知する1対の第1の歪みゲージと引っ 張り歪みを検知する1対の第2の歪みゲージを、第1の 歪みゲージと第2の歪みゲージを組とする2組に分け、 前記ビーム体の同一平面上に、それぞれの組が荷重点か ら等しい距離になるように配置するとともに一方の組を 変形部の最大歪み発生部位に配置し、一方の組の荷重点 からの距離をL1 とし、この距離L1 における前記ビー 30 ム体の幅をW1 とし、他方の組の荷重点からの距離をL 2 とし、この距離L2 における前記ビーム体の幅をW2 としたとき、W1 /L1 =W2 /L2 の関係が略成立す るように他方の組を配置し、かつ第1の歪みゲージと第 2の歪みゲージが交互になるようにしてリング状に配置 し、この各歪みゲージでブリッジ回路を構成したことを 特徴とするロードセル。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、荷重を検出する荷 40 重検出器等に使用するロードセルに関する。

[0002]

【従来の技術】一般に、ロードセルは、図7に示すよう に、ビーム体1の変形部2a, 2b, 2c, 2dを平行 四辺形状に配置し、上側の変形部2a, 2bの上面に歪 みゲージ3a、3bを配置したロバーバル機構のものが 知られている。しかし、このような構成のロードセル は、ビーム体1の加工コストが高く、また、小形化が困 難となるなどの問題がある。このようなことから、特公 平2-3882号公報では、片持ち梁構造からなり、中 50 第1の歪みゲージと引っ張り歪みを検知する1対の第2

間部に変形部を有するビーム体の一端を固定端、他端を 自由端とし、この自由端に荷重点を有する平板状のロー ドセルを提案している。すなわち、この公報のものは、 ロードセルを平板状にすることで、小形化を実現し、ま た、コスト低下を実現し、さらには薄膜プロセスにより 直接ビーム体に歪みゲージパターンを形成できるように している。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】上述した公報のような 平板状のロードセルは出力電圧が比較的小さいため、後 段に増幅率(ゲイン)の大きい増幅器を配置して出力を 増幅することが必要となる。しかし、増幅率を大きくし た場合、ノイズの影響を無視できなくなり、ビーム体上 に形成している各歪みゲージ間を接続するとともに各歪 みゲージと入出力端子間を接続するリード配線パターン の長さが問題になる。すなわち、リード配線パターンが 長いとリード配線パターンの抵抗の温度特性により温度 ドリフト等の影響を受け、これがノイズとして出力側に 現れ、S/N比が低下して荷重検出に悪影響を及ぼすこ **20** とになる。

【0004】そこで、請求項1記載の発明は、平板状の ビーム体上に形成するリード配線パターンを短くでき、 これにより温度ドリフト等の影響を軽減して出力のS/ N比を高めることができるロードセルを提供する。

【0005】また、請求項2記載の発明は、平板状のビ ーム体上に形成するリード配線パターンをさらに短くで き、これにより温度ドリフト等の影響をさらに軽減して 出力のS/N比をより高めるごとができ、しかも、最大 の出力電圧を得ることができるとともに製作が容易な口 ードセルを提供する。

【0006】また、請求項3記載の発明は、平板状のビ ーム体上に形成するリード配線パターンを短くでき、こ れにより温度ドリフト等の影響を軽減して出力のS/N 比をより高めることができ、しかも、最大の出力電圧を 得ることができるロードセルを提供する。

[0007]

【課題を解決するための手段】請求項1記載の発明は、 片持ち梁構造からなり、中間部に変形部を有するビーム 体の一端を固定端、他端を自由端とし、この自由端に荷 重点を有する平板状のロードセルにおいて、圧縮歪みを 検知する1対の第1の歪みゲージと引っ張り歪みを検知 する1対の第2の歪みゲージを、ビーム体の同一平面上 に、第1の歪みゲージと第2の歪みゲージが交互になる ようにしてリング状に配置し、この各歪みゲージでブリ ッジ回路を構成したことにある。

【0008】請求項2記載の発明は、片持ち梁構造から なり、中間部に変形部を有するビーム体の一端を固定 端、他端を自由端とし、この自由端に荷重点を有する平 板状のロードセルにおいて、圧縮歪みを検知する1対の の歪みゲージを、ビーム体の同一平面上に、荷重点から 等しい距離で、かつ変形部の最大歪み発生部位に配置す るとともに、この第1の歪みゲージと第2の歪みゲージ が交互になるようにしてリング状に配置し、この各歪み ゲージでブリッジ回路を構成したことにある。

【0009】請求項3記載の発明は、片持ち梁構造から なり、中間部に変形部を有するビーム体の一端を固定 端、他端を自由端とし、この自由端に荷重点を有する平 板状のロードセルにおいて、圧縮歪みを検知する1対の 第1の歪みゲージと引っ張り歪みを検知する1対の第2 10 の歪みゲージを、第1の歪みゲージと第2の歪みゲージ を粗とする2組に分け、ビーム体の同一平面上に、それ ぞれの組が荷重点から等しい距離になるように配置する とともに一方の組を変形部の最大歪み発生部位に配置 し、一方の組の荷重点からの距離をL1 とし、この距離 L1 におけるビーム体の幅をW1 とし、他方の組の荷重 点からの距離をL2 とし、この距離L2 におけるビーム 体の幅をW2 としたとき、W1 /L1 =W2 /L2 の関 係が略成立するように他方の組を配置し、かつ第1の歪 みゲージと第2の歪みゲージが交互になるようにしてリ ング状に配置し、この各歪みゲージでブリッジ回路を構 成したことにある。

[0010]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態を図面 を参照して説明する。

(第1の実施の形態)図1及び図2に示すように、中間 部の同一位置の両側に変形部11a,11bを形成した 長方形の平板状のビーム体12の上面に絶縁樹脂層13 を形成し、その上に圧縮歪みを検知する1対の第1の歪 1対の第2の歪みゲージパターンRT1, RT2、リード配 線パターンLe 、入力端子パターンVe+, Ve-及び出力 端子パターンVo+, Vo-をそれぞれ形成している。前記 ビーム体12は長手方向の一端を固定端とし、この固定 端側にビーム体12を取付けるための孔14を設け、他 端を自由端とし、この自由端側に荷重受けピン15を設 けている。すなわち、このロードセルのビーム体は片持 ち梁構造になっている。

【0011】前記ビーム体12は、平板の高力アルミ等 の板材を機械加工やプレス等で所定の形状に加工して製 40 作する。前記絶縁樹脂層13は、前記ビーム体12を洗 浄後、絶縁樹脂を塗布し、さらに加熱硬化して形成す る。前記各パターンRC1, RC2、RT1, RT2、Le 、V et, Ve-、Vot, Vo-は、前記ビーム体12の上に形成 した絶縁樹脂層13の上に、スパッタリング等の方法で 積層成膜して形成する。先ず、Ni Cr Si の合金から なるストレンゲージ抵抗体を厚さ約0. 1μmに積層 し、その上にCu からなるリード配線層を厚さ約2μm に積層し、これをフォトエッチングにより図に示すよう な所定のパターンにする。すなわち、歪みゲージパター 50

ンRC1, RC2、RT1, RT2の部分はストレンゲージ抵抗 体のみにし、リード配線パターンLe と入出力端子パタ ーンVe+, Ve-、Vo+, Vo-の部分はストレンゲージ抵 抗体の上にリード配線層が積層した状態にする。その他 は全てストレンゲージ抵抗体もリード配線層も除去す る、

【0012】第1の歪みゲージパターンRC1、RC2と第 2の歪みゲージパターンRT1, RT2の配置は、第1の歪 みゲージパターンRC1を変形部11a、11bの最大歪 み発生部位である中心部に中央部を位置させてビーム体 12の幅方向に平行に、しかも変形部11a側に配置 し、第2の歪みゲージパターンRT1を同じく変形部11 a, 11bの最大歪み発生部位である中心部に中央部を 位置させてビーム体12の長手方向に平行に、しかも変 形部11b側に配置している。また、第1の歪みゲージ パターンRC2を変形部11a,11bの中心部から所定 距離固定端側に離れた変形部位内の位置に中央部を位置 させてビーム体12の幅方向に平行に、しかも変形部1 1b側に配置し、第2の歪みゲージバターンRT2を同じ く変形部11a,11bの中心部から所定距離固定端側 に離れた変形部位内の位置に中央部を位置させてビーム 体12の長手方向に平行に、しかも変形部11a側に配 置している。

【0013】そして、第1の歪みゲージパターンRCIの 一端と第2の歪みゲージパターンRT1の一端と入力端子 パターンVetをリード配線パターンLe で接続するとと もに第1の歪みゲージパターンRCIの他端と第2の歪み ゲージパターンRT2の一端と出力端子パターンVo+をリ ード配線パターンLe で接続している。また、第1の歪 みゲージパターンRC1,RC2、引っ張り歪みを検知する 30 みゲージパターンRC2の一端と第2の歪みゲージパター ンRT1の他端と出力端子パターンVo-をリード配線パタ ーンLe で接続するとともに第1の歪みゲージパターン RC2の他端と第2の歪みゲージパターンRT2の他端と入 力端子パターンVe-をリード配線パターンLe で接続 し、第1の歪みゲージと第2の歪みゲージを交互にかつ リング状に配置している。

> 【0014】前記ビーム体12上に形成した薄膜パター ンを等価回路で示すと図3に示すようになる。 すなわ ち、第1の歪みゲージパターンRCI,RC2と第2の歪み ゲージRT1、RT2の配置はブリッジ回路に対応したリン グ状配置になっている。このような構成のロードセルで は、荷重受けピン15に図中矢印で示すように荷重Pが 印加すると、第1の歪みゲージパターンRC1、RC2は、 ビーム体材のポアッソン比に相当する圧縮応力が生じ る。従って、第1の歪みゲージパターンRC1, RC2はこ の圧縮応力が生じる方向、すなわち、引っ張り歪みの生 じる方向に直角に配置する。また、第2の歪みゲージパ ターンRT1, RT2は、引っ張り歪みの生じる方向に平行 に配置する。

【0015】このように第1の歪みゲージパターンRC

1, RC2と第2の歪みゲージパターンRT1, RT2を配置 することで、片面の板状のピーム体であっても、通常の ロバーバル機構のロードセルのフルブリッジに近いブリ ッジ回路を構成でき、所定のビーム体の変形量に対応し た出力電圧を得ることができる。

【0016】例えば、荷重点(荷重受けピン15の位 置) に印加する荷重をP、ビーム体の厚さをt、歪みゲ ージ位置の荷重点からの距離をL、ビーム体の幅をW、 ビーム体のヤング率をE、歪みゲージ位置の歪み量を ε 1 (経弾性歪み量)及び Et (横弾性歪み量)、歪みゲ 10 ージのゲージ率をk、ブリッジ回路の入力電圧をVe 、 出力電圧をVo 、 $\varepsilon t = 0$. $3 \times \varepsilon 1$ とすると、 $\varepsilon = 6$ $P \cdot L / (E \cdot W \cdot 2t)$ となり、Vo =Ve · k (ε $1 + \varepsilon 1 + \varepsilon t + \varepsilon t$) $/ 4 \ge 3 \delta$.

【0017】従って、出力電圧を大きく得るには、 61 、et をピーム体に印加する荷重に対し、永久変形等 が生じない最大の変形量に対応するように設定すること が必要となる。ビーム体材料の弾性限界内での大きさに 限定する必要があり、しかも定格荷重の保証は勿論、最 大荷重や所定の繰返し荷重にも耐えられるように許容さ 20 れる最大値で設計するのがよい。従って、4個の歪みゲ ージRC1, RC2, RT1, RT2の歪み量を等しくすること が最適である。

【0018】荷重点から歪みゲージパターンRC1、RT1 の中心位置までの距離をL1、ここでのビーム体の幅を W1、また、荷重点から歪みゲージパターンRC2、RT2 の中心位置までの距離をL2、ここでのビーム体の幅を W2 とすると、歪みの大きさは公知の材料力学から得ら れる自然法則から、L1 /W1 = L2 /W2 なる関係式 が成立するように各歪みゲージを配置することで荷重点 30 に荷重が印加したときそれぞれの歪みゲージRC1、RC 2、RT1、RT2の歪み量は等しくなる。このように各歪 みゲージを配置した場合の出力電圧は、フルブリッジの 場合に比べて2.6/4=0.65倍の出力が得られ、 ハーフブリッジよりも大きな出力電圧が得られる。

【0019】また、第1の歪みゲージRCI、RC2と第2 の歪みゲージRT1、RT2が、RC1-RT1-RC2-RT2の ように、交互になるようにしてリング状に配置してブリ ッジ回路を構成しているので、各歪みゲージ間を接続す るリード配線パターンLe 及び各歪みゲージの接続点と 40 各入出力端子パターンVe+, Ve-、Vo+, Vo-を接続す るリード配線パターンLe が簡単となり、リード配線パ ターンの長さを短くできる。従って、リード配線パター ンLe の抵抗の温度特性等による温度ドリフト等の影響 を軽減でき、ノイズの影響を無くして出力のS/N比を 高めることができる。

【0020】例えば、リード配線パターンLe として、 厚さ0. 1μmのNi Cr Si 層の上に厚さ2μmのC u 層を積層して形成したとすると、シート抵抗は0.0 mで長さが2mmのとき、リード抵抗は、0.015× 2000/200=0.15Ωになる。このときの抵抗 温度係数が3000ppm/℃であったとすると、この ロードセルの温度が40℃変化したときの抵抗変化は、 0. $15 \times 3000 \times 10^{-6} \times 40 = 18 \times 10^{-3} \Omega$ になる。ブリッジ回路の入力電圧Ve が10Vで、各歪 みゲージRC1、RC2、RT1、RT2の抵抗が800Ωのと きの出力電圧変動は、

6

 $\Delta V_0 = 1.0 \times (2/4) \times (1.8 \times 10^{-3}/800)$ $=0.113 \,\mathrm{mV}$

になる。 定格出力VO を10mVとすると、ΔVo /V o = 1.3% c

【0021】検出精度が1/1000のロードセルの場 合、この温度ドリフト量は許容範囲を越えた量になって しまう。従って、この温度ドリフト量を低減させるため には、ブリッジ回路内のリード配線抵抗を極力低減させ る必要がある。この実施の形態ではリード配線パターン Le の長さを極力短くしてリード配線抵抗の低減を実現 している。

- 【0022】また、各歪みゲージRCI、RC2、RT1、R T2を、荷重点から歪みゲージRC1、RT1の中心位置まで の距離をL1、ここでのビーム体の幅をW1、また、荷 重点から歪みゲージRC2、RT2の中心位置までの距離を L2 、ここでのビーム体の幅をW2 としたとき、L1 / W1 = L2 /W2 なる関係式が成立するように配置して いるので、各歪みゲージRC1、RC2、RT1、RT2を配置 したビーム体の歪み量を等しくでき、これにより、最大 の変形可能なビーム寸法を決めることができ、最大の出 力電圧を得ることができる.
- 【0023】図4は前述したロードセルを使用した荷重 検出装置の一例を示す概略構成図で、21は、ビーム体 12の上面に歪みゲージパターンRC1, RC2, RT1, R T2、リード配線パターンLe 、入出力端子パターンVe +, Ve-, Vo+, Vo-を形成したもので、このロードセ ル21を内部を中空にしたハウジング22の中空部に固 定している。すなわち、ロードセル21の固定端をねじ 23によって中空部内に設けた固定部24に固定してい る。また、このロードセル21の自由端に設けた荷重受 けピン15に荷重受けスプリング25の一端側を固定
- し、この荷重受けスプリング25の他端側に荷重伝達棒 26を固定し、この荷重伝達棒26を前記ハウジング2 2に開けたガイド孔27を貫通して外部に突出させてい

【0024】この荷重検出装置は、入力端子Vet, Ve-に所定の入力電圧が印加している状態で、図中矢印で示 すように、外部から荷重伝達棒26に荷重Pが印加する と、荷重受けスプリング25を介して荷重受けピン15 に荷重が伝達され、ビーム体12に歪みが生じる。これ を歪みゲージパターンRC1, RC2, RT1, RT2で検出 15Ωになる。 リード配線パターンLe の幅が200μ 50 し、ブリッジ回路からリード配線 Le を介して出力端子

Vo+, Vo-に出力電圧を出力する。こうして、荷重伝達 棒26に印加した荷重に対応した出力電圧が出力端子V o+, Vo-から出力されることになる。

【0025】(第2の実施の形態) 図5に示すように、 中間部の同一位置の両側に変形部31a,31bを形成 した長方形の平板状のビーム体32の上面に絶縁樹脂層 を形成し、その上に圧縮歪みを検知する1対の第1の歪 みゲージパターンRC1、RC2、引っ張り歪みを検知する 1対の第2の歪みゲージパターンRT1, RT2、リード配 線パターンLe 、入力端子パターンVe+, Ve-及び出力 10 端子パターンVo+、Vo-をそれぞれ形成している。前記 ビーム体32は長手方向の一端を固定端とし、この固定 端側にビーム体32を取付けるための孔34を設け、他 端を自由端とし、この自由端側に荷重受けピン35を設 けている。

【0026】前記ビーム体32は、平板の高力アルミ等 の板材を機械加工やプレス等で所定の形状に加工して製 作する。前記絶縁樹脂層は、ビーム体32を洗浄後、絶 緑樹脂を塗布し、さらに加熱硬化して形成する。前記各 パターンRC1、RC2、RT1、RT2、Le 、Ve+, Ve-、 Vo+, Vo-は、前記ビーム体32の上に形成した絶縁樹 脂層の上に、スパッタリング等の方法で積層成膜して形 成する。すなわち、第1の実施の形態と同様に、先ず、 Ni CrSi の合金からなるストレンゲージ抵抗体を厚 さ約0.1µmに積層し、その上にCu からなるリード 配線層を厚さ約2μmに積層し、これをフォトエッチン グにより図に示すような所定のパターンにする。すなわ ち、歪みゲージパターンRC1, RC2、RT1, RT2の部分 はストレンゲージ抵抗体のみにし、リード配線パターン Le と入出力端子パターンVe+, Ve-、Vo+, Vo-の部 30 分はストレンゲージ抵抗体の上にリード配線層が積層し た状態にする。その他は全てストレンゲージ抵抗体もリ ード配線層も除去する。

【0027】第1の歪みゲージパターンRCI、RC2と第 2の歪みゲージパターンRT1、RT2の配置は、第1の歪 みゲージパターンRCI、Rc2を変形部31a、31bの 最大歪み発生部位である中心部に中央部を位置させてビ ーム体32の幅方向に平行に配置し、また、第2の歪み ゲージパターンRT1, RT2を同じく変形部31a,31 bの最大歪み発生部位である中心部に中央部を位置させ 40 ゲージパターンRC1, RC2, RT1, RT2を形成するの てビーム体32の長手方向に平行に配置し、かつ、変形 部31a側から変形部31b側に、歪みゲージRT1、歪 みゲージRC1、歪みゲージRT2、歪みゲージRc2のよう に交互に配置している。

【0028】そして、第1の歪みゲージパターンRCIの 一端と第2の歪みゲージパターンR『1の一端と入力端子 パターンVe+をリード配線パターンLe で接続するとと もに第1の歪みゲージパターンRC1の他端と第2の歪み ゲージパターンRT2の一端と出力端子パターンVo+をリ ード配線パターンLe で接続している。また、第1の歪 50 持ち梁構造のビーム体の性質から各歪みゲージRC1, R

みゲージパターンRC2の一端と第2の歪みゲージパター ンRT1の他端と出力端子パターンVo-をリード配線パタ ーンLe で接続するとともに第1の歪みゲージパターン RC2の他端と第2の歪みゲージパターンRT2の他端と入 力端子パターンVe-をリード配線パターンLe で接続 し、第1の歪みゲージと第2の歪みゲージを交互にかつ リング状に配置している。

8

【0029】この実施の形態においてもビーム体32上 に形成した薄膜パターンを等価回路で示すと図3に示す ようになる。すなわち、第1の歪みゲージパターンRC 1、RC2と第2の歪みゲージRT1、RT2の配置はブリッ ジ回路に対応したリング状配置になっている。このよう な構成のロードセルにおいても、第1の実施の形態と同 様、片面の板状のビーム体であっても、通常のロバーバ ル機構のロードセルのフルブリッジに近いブリッジ回路 を構成でき、所定のビーム体の変形量に対応した出力電 圧を得ることができる。

【0030】また、この実施の形態では、荷重点から歪 みゲージパターンRC1、RT1の中心位置までの距離と荷 20 重点から歪みゲージパターンRC2、RT2の中心位置まで の距離が共にL1 で等しいので、L1 /W1 = L2 (= L1) / W2 (= W1) なる関係式が成立する。従っ て、荷重点に荷重が印加したときそれぞれの歪みゲージ RC1、RC2、RT1、RT2の歪み量は等しくなる。従っ て、この場合においても出力電圧は、フルブリッジの場 合に比べて2.6/4=0.65倍の出力が得られ、ハ ーフブリッジよりも大きな出力電圧が得られる。

【0031】また、第1の歪みゲージRC1、RC2と第2 · の歪みゲージRT1, RT2が、RC1-RT1-RC2-RT2の ように、交互になるようにしてリング状に配置してブリ ッジ回路を構成しているので、各歪みゲージ間を接続す るリード配線パターンLe 及び各歪みゲージの接続点と 各入出力端子パターンVet, Ve-、Vo+, Vo-を接続す るリード配線パターンLe が簡単となり、リード配線パ ターンの長さを短くできる。従って、リード配線パター ンLe の抵抗の温度特性等による温度ドリフト等の影響 を軽減でき、ノイズの影響を無くして出力のS/N比を 高めることができる。

【0032】また、荷重点から等しい距離に全ての歪み で、ビーム体の寸法精度の管理や荷重点からの各歪みゲ ージパターンの距離の管理や各歪みゲージパターンの厚 さや幅の管理が容易となり、ロードセルの製作が容易に なる。また、パターン形状が単純になり、ロードセルを 製作する上での歩留まりを向上できる。

【0033】 (第3の実施の形態) この実施の形態は第 1の実施の形態の変形例で、各入出力端子パターンVe +, Ve-、Vo+, Vo-の配置位置を第1の実施の形態よ りも荷重受けピン15側に近くしている。 すなわち、片

C2、RT1、RT2の位置の歪みの大きさは荷重点からの距 離に比例して大きくなる。そして、荷重の大きさを精度 よく検出するためには最大歪みの生じる変形部11a, 1 1 b の中央部に各歪みゲージRC1、RC2、RT1、RT2 を配置するのが最適であるが、それとは逆に入出力端子 パターンVet、Vet、Vot、Vo-は歪みの極めて小さい 位置に配置することが望まれる。特に、入出力端子パタ ーンにリード線を取出すために半田等を載せた時、歪み の大きな位置に入出力端子パターンを配置すると繰り返 し生じる歪みのために端子部が剥離する可能性が高くな 10 る。一方、板状のビーム体12では端子部を厚くする等 の対策ができない。このため、歪みの小さい荷重点近傍 に入出力端子パターンを配置することが適切である。

【0034】このように各入出力端子パターンVet, V e-、Vo+, Vo-を荷重受けピン15の近傍に配置してい るので、各入出力端子への歪みの影響を少なくでき、端 子部が繰り返し生じる歪みにより剥離するのを防止でき 信頼性を向上できる。なお、この実施の形態においても 各歪みゲージパターンRC1, RC2, RT1, RT2の配置は 第1の実施の形態と同様であり、リード配線パターンL 20 e の長さが若干長くなるが略同様の作用効果が得られ る。

[0035]

【発明の効果】以上、請求項1記載の発明によれば、平 板状のビーム体上に形成するリード配線パターンを短く でき、これにより温度ドリフト等の影響を軽減して出力 のS/N比を高めることができる。

【0036】また、請求項2記載の発明によれば、平板 状のビーム体上に形成するリード配線パターンをさらに 短くでき、これにより温度ドリフト等の影響をさらに軽 30 Vo+, Vo-…出力端子パターン 減して出力のS/N比をより高めることができ、しか

10 も、最大の出力電圧を得ることができるとともに製作が 容易となる。

【0037】また、請求項3記載の発明によれば、平板 状のビーム体上に形成するリード配線パターンを短くで き、これにより温度ドリフト等の影響を軽減して出力の S/N比をより高めることができ、しかも、最大の出力 電圧を得ることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の実施の形態を示すロードセルの 平面図。

【図2】図1のA-A線に沿った断面図。

【図3】同実施の形態におけるロードセルの等価回路

【図4】同実施の形態のロードセルを使用した荷重検出 装置の一例を示す機略構成図。

【図5】本発明の第2の実施の形態を示すロードセルの 平面図。

【図6】 本発明の第3の実施の形態を示すロードセルの 平面図。

【図7】従来のロバーバル機構のロードセルの構成を示 す図。

【符号の説明】

11a, 11b…変形部

12…ビーム体

15…荷重受けピン

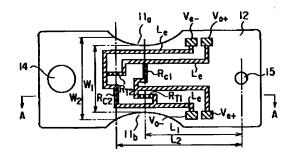
RC1、RC2…第1の歪みゲージパターン

RT1、RT2…第2の歪みゲージパターン

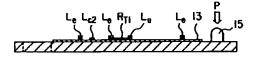
Le …リード配線パターン

Ve+, Ve-···入力端子パターン

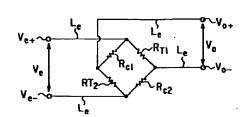
【図1】



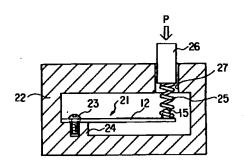
【図2】



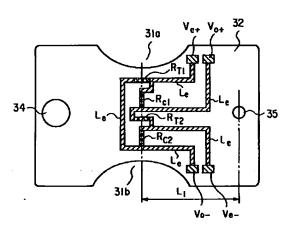
【図3】



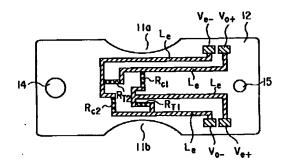
【図4】



【図5】



【図6】



【図7】

